

## KGR

Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 40, mit Schraubverschluss, für Leiterplatten, für Rückseitenmontage

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Temperaturbereich</b>                    | -40 °C/+85 °C                             |
| <b>2. Werkstoffe</b>                           |   |
| Kontaktträger                                  | PA GF                                     |
| Kontaktbuchse 3- bis 8-polig                   | CuZn, untersilbert und vergoldet          |
| Kontaktbuchse 12-polig                         | CuZn, unternickelt und vergoldet          |
| Gehäuse  | Zn-Druckguss, unterkupfert und vernickelt |
| Ringmutter                                     | CuZn, vernickelt                          |
| <b>3. Mechanische Daten</b>                    |   |
| Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig <sup>1</sup> | < 5,0 N                                   |
| Steckkraft/Kontakt 12-polig <sup>2</sup>       | < 5,0 N                                   |
| Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig <sup>1</sup>  | > 1,2 N                                   |
| Ziehkraft/Kontakt 12-polig <sup>2</sup>        | > 0,9 N                                   |
| Kontaktierung mit Schutzart <sup>3</sup>       | Steckern 033098, 033099, SV, WSV IP 40    |
| <b>4. Elektrische Daten</b>                    |   |
| Durchgangswiderstand                           | ≤ 5 mΩ                                    |
| Weiteres siehe Tabelle                         |   |

- <sup>1</sup> gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm  
<sup>2</sup> gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm nach DIN EN 60529  
<sup>3</sup> nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück nach VDE 0110/IEC 60664

- \*a Mutter lose beigelegt  
nut enclosed separately  
écrou ajouté séparément
- \*b Lötpin für Leiterplattenbohrung  
solder pin for bore hole of printed circuit board  
plot à souder pour perçage de la carte imprimée  
Ø 1,0 mm (KGR 30-81)  
Ø 0,7 mm (KGR 120)
- \*c Montagerichtung (Rückseite)  
mounting direction (rear side)  
direction de montage (côté arrière)
- \*d Einbauöffnung  
port  
ouverture d'emplacement

Leiterplattenlayouts siehe Seite 3  
 Printed circuit board layouts see page 3  
 Modèles des cartes imprimées voir à la page 3

Polbilder, von der Lötseite gesehen  
 Pin configurations, solder side view  
 Schémas de raccordement, vus du côté à souder



KGR 30



KGR 40



KGR 50



KGR 50/6



KGR 60



KGR 70



KGR 71



KGR 80



KGR 81



KGR 120

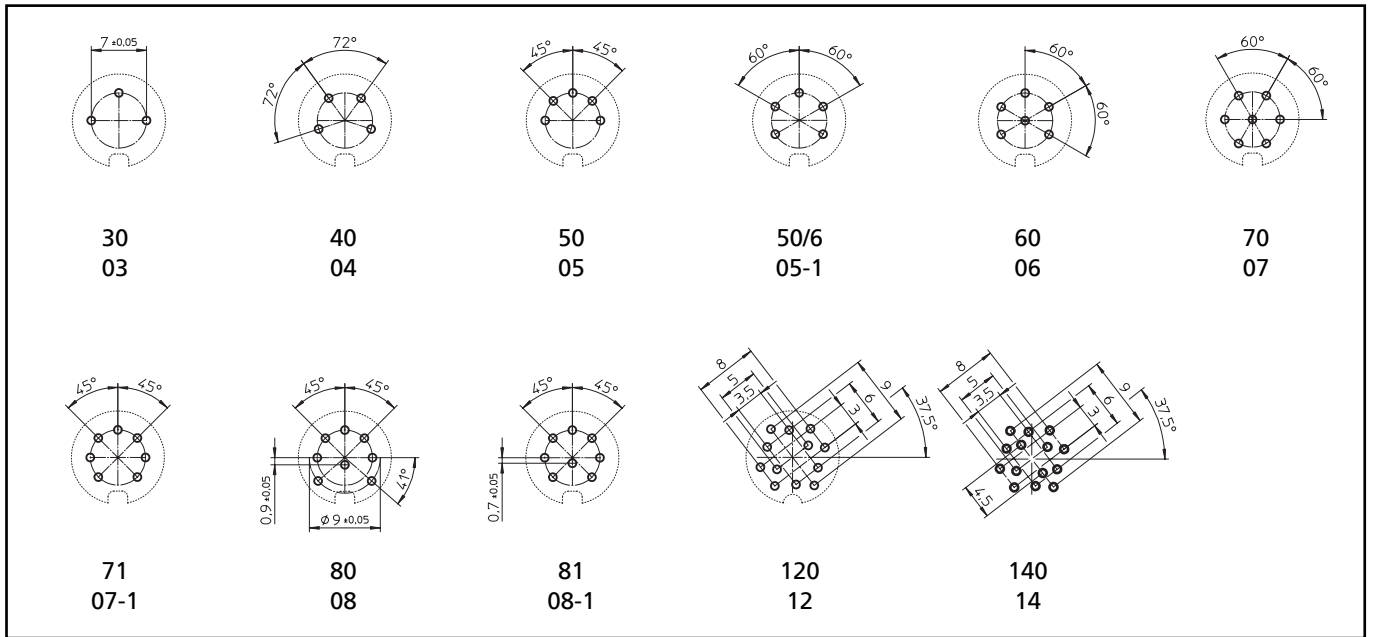
**Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40**  
**Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40**  
**Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40**

<b>KGR</b>	
Chassis socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, with threaded joint, for printed circuit boards, for rear mounting	
<b>1. Temperature range</b>	-40 °C/+85 °C
<b>2. Materials</b>	
Body	PA GF
Contact bush 3 to 8 poles	CuZn, pre-silvered and gilded
Contact bush 12 poles	CuZn, pre-nickel and gilded
Housing	Zn diecast, pre-coppered and nickel
Ring nut	CuZn, nicked
<b>3. Mechanical data</b>	
Insertion force/contact 3–8 poles <sup>1</sup>	< 5,0 N
Insertion force/contact 12 poles <sup>2</sup>	< 5,0 N
Withdrawal force/contact 3–8 poles <sup>1</sup>	> 1,2 N
Withdrawal force/contact 12 poles <sup>2</sup>	> 0,9 N
Mating with	plugs 033098, 033099, SV, WSV
Protection <sup>3</sup>	IP 40
<b>4. Electrical data</b>	
Contact resistance	≤ 5 mΩ
For further information please see table	
<sup>1</sup>	measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
<sup>2</sup>	measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm
<sup>3</sup>	according to DIN EN 60529,
<sup>4</sup>	only in locked position with a proper counterpart according to VDE 0110/IEC 60664

<b>KGR</b>	
Embase femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, avec verrouillage à vis, pour cartes imprimées, pour montage par derrière	
<b>1. Température d'utilisation</b>	-40 °C/+85 °C
<b>2. Matériaux</b>	
Corps isolant	PA GF
Prise de contact 3 à 8 pôles	CuZn, sous-argenté et doré
Prise de contact 12 pôles	CuZn, sous-nickelé et doré
Boîtier	Zn moulé sous pression, sous-cuivré et nickelé
Écrou à anneau	CuZn, nickelé
<b>3. Caractéristiques mécaniques</b>	
Force d'insertion/contact 3–8 pôles <sup>1</sup>	< 5,0 N
Force d'insertion/contact 12 pôles <sup>2</sup>	< 5,0 N
Force de séparation/contact 3–8 pôles <sup>1</sup>	> 1,2 N
Force de séparation/contact 12 pôles <sup>2</sup>	> 0,9 N
Raccordement avec	connecteurs mâles 033098, 033099, SV, WSV
Protection <sup>3</sup>	IP 40
<b>4. Caractéristiques électriques</b>	
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Pour plus de détails, voir tableau s.v.p.	
<sup>1</sup>	mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
<sup>2</sup>	mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,0 mm
<sup>3</sup>	suivant DIN EN 60529,
<sup>4</sup>	uniquement à l'état verrouillé avec un propre pendant suivant VDE 0110/CEI 60664

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Pôles Pôles	Verpackungseinheit (VE) Package unit (PU) Unité d'emballage (UE)					
			Bemessungsstrom Rated current Courant assigné	Bemessungsspannung <sup>4</sup> Rated voltage <sup>4</sup> Tension assignée <sup>4</sup>	Prüfspannung Test voltage Tension de claquage	Isolationswiderstand Insulation resistance Résistance d'isolement	Kontaktkapazität Contact capacitance Capacité de contact
			A	V AC	kV AC eff.	Ω	pF
<b>KGR 30</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>10<sup>13</sup></b>	<b>~ 2</b>
<b>KGR 40</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>10<sup>13</sup></b>	<b>~ 2</b>
<b>KGR 50</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>10<sup>12</sup></b>	<b>~ 3</b>
<b>KGR 50/6</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>10<sup>13</sup></b>	<b>~ 2</b>
<b>KGR 60</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>10<sup>13</sup></b>	<b>~ 2</b>
<b>KGR 70</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>10<sup>13</sup></b>	<b>~ 2</b>
<b>KGR 71</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>10<sup>12</sup></b>	<b>~ 3</b>
<b>KGR 80</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>10<sup>12</sup></b>	<b>~ 3</b>
<b>KGR 81</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>10<sup>12</sup></b>	<b>~ 3</b>
<b>KGR 120</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>10<sup>12</sup></b>	<b>~ 3</b>

Verpackung: im Karton  
 Packaging: in a cardboard box  
 Emballage: dans un carton



Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder, von der Bestückungsseite gesehen  
 Printed circuit board layouts for chassis connectors, components side view  
 Modèles des cartes imprimées pour embases, vus du côté à équiper